

无锡芯朋微电子股份有限公司

关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下称“芯朋微”或“公司”）2025年5月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”、“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”及“苏州研发中心项目”内部投资结构进行调整。公司监事会及保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2138号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）17,904,986股，每股面值1元，发行价格为54.11元/股，募集资金总额为人民币968,838,792.46元，扣除发行费用8,955,125.23元（不含税），本公司实际募集资金净额为人民币959,883,667.23元。上述募集资金到位情况由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2023]B069号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募投项目情况

根据公司披露的《2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书》及

公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011），公司向特定对象发行股票募投项目截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投入金额	募集资金累计投入金额
1	新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	33,928.29	33,928.29	9,954.09
2	工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	42,794.66	41,899.15	9,115.21
3	苏州研发中心项目	20,160.93	20,160.93	9,944.94
合 计		96,883.88	95,988.37	29,014.24

三、本次调整募投项目内部投资结构的原因及情况

（一）调整募投项目内部投资结构的原因

公司所处行业为模拟 IC 设计，属于高技术密集型产业，技术研发水平的高低直接影响公司的竞争力。本次募投项目内部投资结构的调整，主要为减少软硬件等资产投资、降低外购 IP 依赖，转而通过加大自研规模、提高自研水平，以保障公司未来长远发展。具体调整原因如下：

- 1、“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”：受上游供应产能充沛影响，“外购设备、共建产线”模式经济效益较低，公司计划降低硬件设备购置，增加与上游供应商技术开发服务；同时，扩大研发人员规模、提高研发人员层次，降低外购 IP 依赖。
- 2、“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”：受上游供应产能充沛影响，“自建测试车间”在公司现有销量之下经济效益较低，公司计划维持委托第三方测试；同时，扩大研发人员规模、提高研发人员层次，降低外购 IP 依赖。
- 3、“苏州研发中心项目”：在保证募投项目正常实施的基础上，公司减少自购房产面积及配套实验室软硬件设备购置；同时，扩大研发人员规模、提高研发人员层次，降低外购 IP 依赖。

(二) 调整募投项目内部投资结构的具体情况如下:

单位: 万元

项目名称	序号	项目	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	金额增减情况
新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目	1	场地购置、装修费用	1,725.00	1,725.00	0
	2	软硬件设备及IP购置	24,921.63	15,321.63	-9,600.00
	3	研发费用	7,281.66	16,881.66	9,600.00
	4	基本预备费	0	0	0
	5	铺底流动资金	0	0	0
	总计	项目总投资	33,928.29	33,928.29	0
工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目	1	场地购置、装修费用	1,900.00	1,900.00	0
	2	软硬件设备及IP购置	33,928.00	20,428.00	-13,500.00
	3	研发费用	6,071.15	19,571.15	13,500.00
	4	基本预备费	0	0	0
	5	铺底流动资金	0	0	0
	合计	项目总投资	41,899.15	41,899.15	0
苏州研发中心	1	场地购置、装修费用	10,350.00	7,250.00	-3,100.00
	2	软硬件设备及IP购置	4,371.15	1,771.15	-2,600.00
	3	研发费用	5,439.78	11,139.78	5,700.00
	4	基本预备费	0	0	0
	合计	项目总投资	20,160.93	20,160.93	0

四、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响

本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据行业发展、实际经营需要及项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关要求。

五、公司履行的审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目的内部投资结构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构系根据募投项目实际进展及未来规划进行的调整，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定的要求。

综上，监事会同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 31 日